

원통형 스테인레스 부식방지용 초미세 구조물

기술분류	표면처리
거래유형	라이선스
기술가격	별도 협의
기술구분	패키징 기술



기술개요

본 기술은 **스테인레스 내부에 초미세 구조물을 형성하여 원통형 스테인레스 내의 부식을 방지하여 제품의 수명을 연장**시킨다. 원통형 스테인레스 내의 초미세 구조물은 초소수형 표면 구조를 지닌 나노 및 마이크로 구조물로 산화 등 부식에 영향을 주는 바이오필름의 형성을 방지한다.

본 기술을 물 파이프, 자동차 및 오토바이 등에 적용하여 스테인레스의 부식을 방지할 수 있다.

기술개발배경

스테인레스의 부식/파이프 형태의 곡면의 경우 패턴 형성으로 표면 처리 어려움/

기존기술 한계

- 포토리소그래피 공정을 이용하여 기판상에 초미세패턴(100nm 이하) 형성 어려움
- 빛을 이용한 다중 공법은 가공시간이 오래 걸리고 공정이 복잡하여, 제조 비용 상승
- 패턴의 형성될 기판의 표면이 편평하지 않으면 빛의 반사, 회절, 세기 변화 등에 의해 공정이 복잡해 짐



개발기술 특성

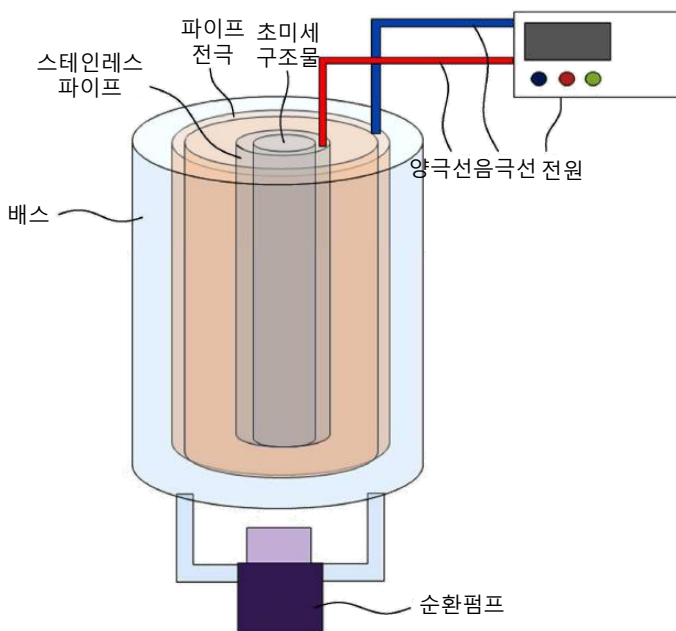
- 스테인레스 내부에 초소수성 표면 구조인 초미세 구조물로 바이오필름을 형성하지 부식 방지
- 곡면 구조의 형태에 용이하게 적용
- 물이 스테인레스 표면에 머무는 시간을 단축 시키며, 물에 녹아 생성된 질산/황산 이온이 표면과 접촉하는 것을 방지
- 초미세 구조물로 스테인레스 표면의 두께를 줄임

기술구현

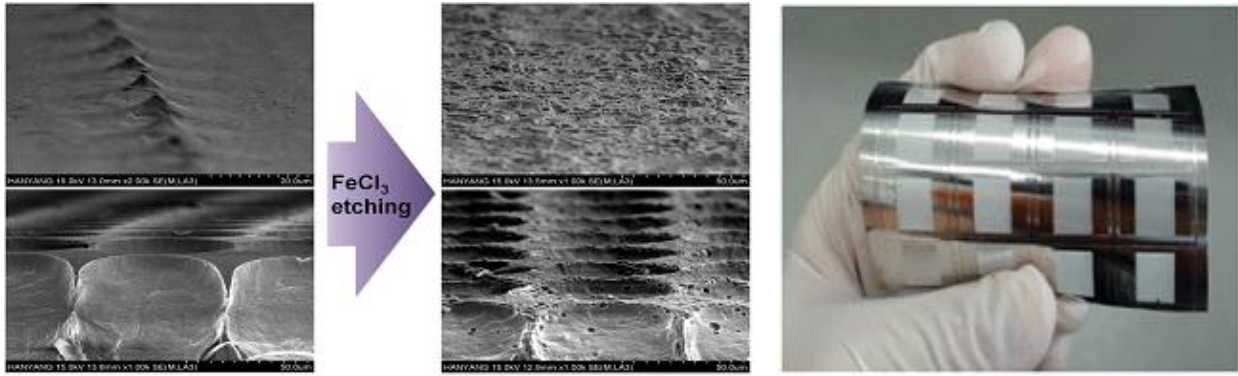
본 초미세 구조물 제조장치의 구성은 아래와 같다.

- 중공의 배스
- 배스 내부에 위치하는 파이프 전극
- 파이프 전극 내부에 위치하는 스테인레스 파이프
- 파이프 전극 및 스테인레스 파이프에 전하를 공급하는 전력공급부

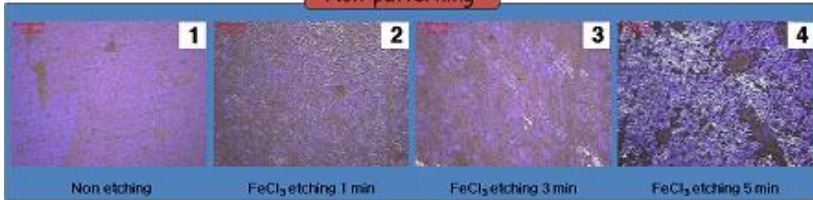
[초미세 구조물 장치]



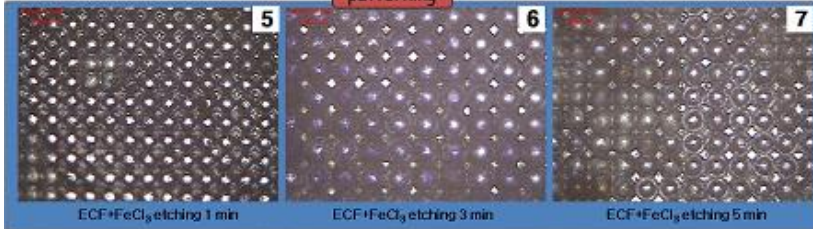
주요도면, 사진



Non-patterning



patterning



기술완성도

TRL 1 > TRL 2 > TRL 3 > TRL 4 > TRL 5 > TRL 6 > TRL 7 > TRL 8 > TRL 9

연구실 규모의 부품/시스템 성능 평가 완료

기술활용분야

곡면 형태의 스테인레스 부식 방지 처리

시장동향

- 2011년 세계 스테인레스 조강생산량은 3천 2백만톤으로 중국 천2백6십만톤, 한국 216만톤, 일본 325만톤 생산
- 세계 스테인리스 시장에서 한·중·일간 과잉 공급으로 경쟁 지속
- 국내 시자는 포스코가 가장 크게 생산하고 있으며, 포스코와 냉연사의 갈등구조로 열연 수출과 수입비 동시 증대
- 국내 생산능력 증대에도 불구, 스테인리스 냉연 수입 지속적 증가

지식재산권 현황

No.	특허명	출원일자	등록번호	IPC
1	원통형 스테인레스 내의 부식 방지를 위한 초미세 구조물 제조 장치	2011.12.22	10-1316286	C23F 13/00
2	니켈-코발트-탄화수소 도금액 및 이를 이용한 철강연속 주조용 동몰드 표면처리방법	2009.05.29	10-1103844	C25D 3/12
3	가스 클러스터 코팅을 이용한 메소포러스 TiO2 피막을 형성시킨 스테인레스 전극 및 극 제조 방법 및 장치	2010.05.17	10-1189890	C25B 11/10